

財團法人工業技術研究院 函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：林秀姿

電話：03-5916636

傳真：03-5820466

E-mail：iris.lin@itri.org.tw



108000475017

10846 台北市萬華區長沙街 2 段 73 號 3 樓

受文者：台北市儀器商業同業公會

發文日期：中華民國 108 年 03 月 27 日

發文字號：工研轉字第 1080004750 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：為本院「雷射加工、雷射源及量測檢測等相關專利讓與案」公開招標活動，敬請轉知 貴會會員等相關廠商重要資訊，把握機會參與本活動，請 查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智財防護能力，本院將辦理雷射加工、雷射源及量測檢測等相關專利 39 案 51 件之讓與公開招標活動。「讓與標的」共分為五個類別：(一)雷射加工技術(11 案 14 件)、(二)雷射源技術(8 案 12 件)、(三)平面顯示器技術(4 案 7 件)、(四)半導體技術(7 案 7 件)及(五)量測檢測技術(9 案 11 件)。部分「讓與標的」為科專成果，部分屬工研院自有成果(詳如附件)。

二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：

(一) 工研院研發成果公告網站

<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>

(二) 台灣技術交易資訊網

<https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx>

三、本案截標日為 108 年 4 月 24 日，開標日為 108 年 4 月 25 日。

四、公開說明會：

（一）舉辦時間：民國（下同）108 年 4 月 19 日 15 時。

（二）舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 111 室。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 4 月 17 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「雷射加工、雷射源及量測檢測等相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）向本案聯絡人報名。聯絡人將於 108 年 4 月 18 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會議資訊。

五、本案聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 林小姐

電話：(03)591-6636

傳真：(03)582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台北市儀器商業同業公會

院長



依權責劃分規定授權業務主管決行



工業技術研究院 雷射加工、雷射源及量測檢測等相關專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含雷射加工、雷射源及量測檢測等相關專利 39 案 51 件（以下簡稱「讓與標的」）。「讓與標的」共分為五個類別：（一）雷射加工技術（11 案 14 件）、（二）雷射源技術（8 案 12 件）、（三）平面顯示器技術（4 案 7 件）、（四）半導體技術（7 案 7 件）及（五）量測檢測技術（9 案 11 件）。部分「讓與標的」為科專成果，部分屬工研院自有成果。詳細情形請參「附件：讓與標的清單」。

「讓與標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網（<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>）、及工研院研發成果公告網站（<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>）。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）108 年 4 月 19 日 15 時於工研院中興院區 51 館 111 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 4 月 17 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「雷射加工、雷射源及量測檢測等相關專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 108 年 4 月 18 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 108 年 4 月 24 日下午 5 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。



五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「雷射加工、雷射源及量測檢測等相關專利讓與案投標」並標示出欲投標的技術類別(共五類)，於截標日 108 年 4 月 24 日下午 5 時整(含)前(以送達收據為憑)掛號寄達或親送至：
31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室
工研院技轉法律中心 林小姐 收
2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

八、決標方法：

1. 開標日為 108 年 4 月 25 日(開標時間及地點另行通知投標廠商)。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家(含)以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。



4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會



被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「讓與標的」之讓與登記手續由得標廠商負責辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，下同)及立法院經濟委員會為境外實施等一切必要之申請(包括但不限於境外實施之申請等)，並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院、主管機關及立法院經濟委員會核准及同意後始得為之：
 - (1) 得標廠商在我國管轄區域(係指台、澎、金、馬，下同)外自行使用、實施者；
 - (2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
 - (3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
 - (4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。
13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」中之科專成果收歸國有：



- (1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」中之科專成果，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
- (2) 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」中之科專成果者。
- (3) 為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。
15. 得標廠商應使所有「後手」遵守九、契約事項第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、及第 16 項之約定。得標廠商應與「後手」約定，如「後手」違反前述約定，工研院得直接對「後手」主張權利。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之法人或中華民國國民就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 林小姐

電話：(03) 591-6636，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：讓與標的清單

技術分類	次分類	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	專利證號	專利起期	專利迄期	科專/自有	專利種類	契約運用
(一) 雷射加工技術 (11 案 14 件)	LED 切割	1	1	P27010042TW	雷射加工裝置及其方法	獲證	台灣	I483802	2015 0511	2032 1213	科專	發明	
	加工製程方法	2	2	P27010054TW	三維加工裝置	獲證	台灣	I496643	2015 0821	2032 1129	科專	發明	
	加工製程方法(半導體)	3	3	P27000044TW	發光二極體元件、其導光結構的形成方法與形成設備	獲證	台灣	I447955	2014 0801	2031 1122	科專	發明	
			4	P27000044US		獲證	美國	8,823,032	2014 0902	2032 1224	科專	發明	
		4	5	P27960105TW	以光學方法產生圖案化之極短紫外光源用於圖案加工之裝置及其方法	獲證	台灣	I388941	2013 0311	2028 0402	科專	發明	
			6	P27990022TW		獲證	台灣	I440175	2014 0601	2030 1101	科專	發明	
	加工製程方法(Touch、FPD、PV)	6	7	P27970045TW	圖案化多晶氧化銦錫之方法	獲證	台灣	I384551	2013 0201	2028 1023	科專	發明	曾非專屬授權
			8	P27970045US		獲證	美國	7,879,712	2011 0201	2029 0305	科專	發明	
		7	9	P27980058TW	以飛秒雷射製作多晶矽圖案的方法和系統	獲證	台灣	I406106	2013 0821	2029 1112	科專	發明	
	飛秒加工製程(生醫微流道)	8	10	P27980056TW	光敏玻璃微結構之製造方法及用以製造該微結構之系統	獲證	台灣	I410380	2013 1001	2029 1110	科專	發明	
	除屑裝置	9	11	P27970016TW	微屑移除方法及裝置	獲證	台灣	I340677	2011 0421	2028 0605	科專	發明	曾非專屬授權
			12	P27970016USD1		獲證	美國	8,685,168	2014 0401	2028 1224	科專	發明	
	雷射光學調變與校正	10	13	P27000049TW	可變景深之光學系統與調制方法及其光學加工方法	獲證	台灣	I454331	2014 1001	2031 1114	科專	發明	
	雷射圖案化	11	14	P27960066TW	高效能雷射輔助轉印系統及轉印元件	獲證	台灣	I375498	2012 1021	2027 1120	科專	發明	
(二) 雷射源技術 (8 案 12 件)	雷射源	12	15	P08920109US	光偏振結合元件	獲證	美國	7,006,287	2006 0228	2024 0606	科專	發明	
		13	16	P27000062TW	雷射控制裝置	獲證	台灣	I454006	2014 0921	2031 1117	科專	發明	
		14	17	P27010041TW	雷射裝置及產生雷射光的方法	獲證	台灣	I497850	2015 0821	2032 1108	科專	發明	
			18	P27010041CN		獲證	中國	ZL201210570210.5	2016 0615	2032 1224	科專	發明	
		15	19	P27980008TW	具有濾光薄膜的光纖結構	獲證	台灣	I448753	2014 0811	2029 0730	科專	發明	
			20	P27980008US		獲證	美國	8,204,350	2012 0619	2030 0312	科專	發明	曾非專屬授權
		16	21	P27990019TW	環形迴路光學系統及全光纖式 Q-開關雷射	獲證	台灣	I448024	2014 0801	2030 0919	科專	發明	
		17	22	P27990045TW	光纖雷射系統	獲證	台灣	I400848	2013 0701	2030 1209	科專	發明	
			23	P27990045US		獲證	美國	8,311,065	2012 1113	2031 0326	科專	發明	
		18	24	P27990046TW	雷射倍頻模組	獲證	台灣	I470887	2015 0121	2030 1213	科專	發明	
		19	25	P27990061TW	用於寬頻雷射之偏振調變裝置及其雷射系統	獲證	台灣	I420170	2013 1221	2030 1213	科專	發明	曾非專屬授權
			26	P27990061US		獲證	美國	8,855,152	2014 1007	2033 0318	科專	發明	
(三) 平面顯示	面板缺陷修補	20	27	P27990008TW	平面顯示器之修補方法與系統	獲證	台灣	I430000	2014 0311	2030 0701	科專	發明	
			28	P27990008CN		獲證	中國	ZL201010232684.X	2013 0710	2030 0720	科專	發明	
			29	P27990008US		獲證	美國	8,928,853	2015 0106	2033 1006	科專	發明	



技術分類	次分類	案次	件次	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	專利證號	專利起期	專利迄期	科專/自有	專利種類	契約運用
器 (4 案 7 件)	面板缺陷 修補	21	30	P27990029TW	平面顯示器之修補方法與系統	獲證	台灣	I437338	2014 0511	2030 1014	科專	發明	
			31	P27990029CN		獲證	中國	ZL201010531727.4	2015 0218	2030 1103	科專	發明	
		22	32	P27990063TW	平面顯示模組之修補方法與系統	獲證	台灣	I465791	2014 1221	2030 1130	科專	發明	
	定位/傳送機 構	23	33	P27980037TW	對位裝置與對位方法	獲證	台灣	I418959	2013 1211	2029 1026	科專	發明	曾非專 屬授權
(四) 半導 體技 術 (7 案 7 件)	晶圓盒	24	34	044890008US	晶圓盒氣體充填裝置	獲證	美國	6,135,168	2000 1024	2019 1221	科專	發明	
		25	35	044890021US	應用於標準機械介面之雙導螺桿倍 行程與螺紋差動取放機構	獲證	美國	6352005	2002 0305	2020 0405	科專	發明	
		26	36	044890039US	晶圓載入機	獲證	美國	6,997,664	2006 0214	2024 0113	科專	發明	
		27	37	044890063US	前開式晶圓盒自動載入裝置	獲證	美國	6,896,470	2005 0524	2023 0115	科專	發明	
		28	38	044890079US	晶圓載入機定位方法與裝置	獲證	美國	6,669,185	2003 1230	2020 1207	科專	發明	
		29	39	044900049US	晶圓保持件(Wafer Retainer)	獲證	美國	6,591,987	2003 0715	2022 0219	科專	發明	曾非專 屬授權
		30	40	044910037US	晶圓盒門體之門鎖機構	獲證	美國	6,902,063	2005 0607	2023 0724	科專	發明	曾非專 屬授權
(五) 量測 檢測 技術 (9 案 11 件)	儀器 技術	31	41	P08940003TW	位移量測裝置、方法以及內徑量 測裝置	獲證	台灣	I268339	2006 1211	2025 0524	科專	發明	非專屬 授權中
		32	42	P27000043TW	光譜檢測裝置及光譜檢測方法	獲證	台灣	I456184	2014 1011	2031 1218	科專	發明	
		33	43	P07960005TW	多通道光譜量測裝置與相位差解析 方法	獲證	台灣	I340237	2011 0411	2027 1001	科專	發明	曾非專 屬授權
			44	P07960005CN		獲證	中國	ZL200710188707.X	2010 1229	2027 1114	科專	發明	曾非專 屬授權
		34	45	P07980013TW	噴霧設備、噴霧系統及噴霧設備之 噴霧產生方法	獲證	台灣	I387487	2013 0301	2029 1230	科專	發明	
		35	46	P07940013TW	多重磁場梯度計	獲證	台灣	I295379	2008 0401	2025 1226	自有	發明	曾非專 屬授權
	影像 檢測	36	47	P07970031TW	雙面光學片滾壓對位量測系統及其 方法	獲證	台灣	I381255	2013 0101	2028 1203	科專	發明	
			48	P07970031US		獲證	美國	8,223,335	2012 0717	2030 1217	科專	發明	
		37	49	P07980022TW	雙面光學膜片量測裝置與方法	獲證	台灣	I408331	2013 0911	2029 1216	科專	發明	曾非專 屬授權
	探針 量測	38	50	P07940003TWA1	探針模組	獲證	台灣	I281977	2007 0601	2025 1221	科專	發明	曾非專 屬授權
		39	51	P07950019TW	顯微鏡	獲證	台灣	I325138	2010 0521	2026 1127	科專	發明	曾非專 屬授權

(本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利申請範圍內之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。)